

기술분석보고서 산업재

루켄테크놀러지스(162120)

- ▶ 요약
- ▶ 기업현황
- ▶ 시장동향
- ▶ 기술분석
- ▶ 재무분석
- ▶ 주요 변동사항 및 전망

작성기관 서울평가정보(주) 작 성 자 박진희 책임

[▶ YouTube 요약 영상 보러가기](#)

- 본 보고서는 투자 의사결정을 위한 참고용으로만 제공되는 것이므로, 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 보고서를 활용한 어떠한 의사결정에 대해서도 본회와 작성기관은 일체의 책임을 지지 않습니다.
- 본 보고서의 요약영상은 유튜브로도 시청 가능하며, 영상편집 일정에 따라 현재 시점에서 미공개 상태일 수 있습니다.
- 텔레그램에서 “한국IR협의회” 채널을 추가하시면 매주 보고서 발간 소식을 안내 받으실 수 있습니다.
- 본 보고서에 대한 자세한 문의는 작성기관(TEL.02-3449-1450)으로 연락하여 주시기 바랍니다.

루켄테크놀러지스(162120)

디스플레이 검사장비에서 HBM·AI 반도체용 고정밀 검사부품으로 전환 추진 중

기업정보(2026.05.26 기준)

대표자	안윤태
설립일자	2007년 10월 2일
상장일자	2017년 7월 25일
기업규모	중소기업
업종분류	기타 전기장비 제조업
주요제품	디스플레이 검사 장비 및 부품, 반도체 검사 부품 등

시세정보(2026.05.26 기준)

현재가(원)	2,985
액면가(원)	500
시가총액(억 원)	333
발행주식수	11,156,602주
52주 최고가(원)	3,855
52주 최저가(원)	2,120
외국인지분율	0.22%
주요주주	안윤태 외 9인

■ 디스플레이 사업의 고객 다변화 및 반도체 검사부품 사업 영역 확장으로, 성장성과 수익 안정성을 강화 시도 중

루켄테크놀러지스(이하, 동사)는 2017년 코넥스 시장에 상장한 정밀 검사 솔루션 기업으로, 디스플레이 검사장비·검사부품을 기반으로 반도체 검사부품까지 사업을 확장하고 있다. 디스플레이 패널 검사장비와 Probe Unit을 공급하며, 반도체 부문에서는 M-POGO Pin(Micro POGO Pin), Test Socket, Probe Card, Test Interface Board 등을 개발·제조한다. 향후 성장의 핵심은 디스플레이 장비 매출 변동성을 부품 매출로 보완하고 반도체 고객사향 양산 매출을 확대하는 데 있다.

■ HBM 및 AI 반도체 확산으로 고정밀 검사부품 수요가 확대되는 시장

목표시장은 반도체 검사장비와 디바이스를 연결해 전기적 특성, 기능, 신뢰성을 검증하는 검사부품을 포괄한다. 칩 미세화, 패키지 고도화, HBM(High Bandwidth Memory) 등의 확산으로 테스트 난이도가 높아지면서 고정밀·고신뢰성 검사부품 수요가 확대되고 있다. 특히 Probe Card와 Test Socket은 교체 수요가 발생해 양산라인 가동률과 제품 세대 전환에 연동되는 반복 매출 구조를 형성할 수 있다. 동사는 M-POGO Pin 기반 접촉부품과 Interface Board 제품군으로 시장 변화에 대응하고 있다.

■ 검사부품 수직계열화와 고객사 확보로 반도체 검사부품의 성장 도모

동사는 기존 디스플레이 검사장비·검사부품 중심 사업에서 반도체 검사부품 중심으로 사업 구조를 전환하고 있다. TIU 사업부 인수를 통해 Test Interface Board와 Connector 등 고속 신호전달 부품까지 제품군을 확장했고, 자체 MEMS 기반 M-POGO Pin 기술을 Test Socket, Probe Card 등으로 확대하고 있다. 삼성전자, SK하이닉스 등 주요 반도체 고객사 확보를 추진하면서 HBM 및 AI 반도체 확산에 따른 고정밀 검사부품 수요 증가에 대응하고 있다. 다만 향후 성과는 개발 제품의 양산 채택과 반복 매출 전환 여부에 따라 결정될 것으로 판단된다.

요약 투자지표 (K-IFRS 연결 기준)

	매출액 (억 원)	증감 (%)	영업이익 (억 원)	이익률 (%)	순이익 (억 원)	이익률 (%)	ROE (%)	ROA (%)	부채비율 (%)	EPS (원)	BPS (원)	PER (배)	PBR (배)
2023	385.0	45.3	16.9	4.4	22.9	5.9	15.1	4.6	190.3	208	1,481	22.5	3.2
2024	209.8	-45.5	-33.6	-16.0	-33.2	-15.8	-21.9	-7.1	227.3	-300	1,260	N/A	2.4
2025	173.1	-17.5	-12.0	-6.9	-26.5	-15.3	-19.2	-5.5	277.1	-237	1,216	N/A	2.4

기업경쟁력

반도체 검사부품 수직계열화 기반 확보	<ul style="list-style-type: none"> M-POGO Pin부터 Test Socket, Probe Card, Test Interface Board 및 Connector까지 검사장비와 디바이스 사이의 접촉·신호전달 부품을 포괄하는 제품 구조 확보
디스플레이 검사기술 축적	<ul style="list-style-type: none"> 디스플레이 검사장비와 검사부품 사업에서 축적한 고객 맞춤형 설계, 정밀 검사, 장비 제작 및 납기 대응 경험 기반 고객다변화 및 반도체 검사부품 사업 확장
반도체 Contact 검사 및 회로기술 내재화	<ul style="list-style-type: none"> 전문 인력 확보, 제품개발 및 M-POGO Contact 검사부품, PCB 회로설계 기술 내재화 기반을 바탕으로 주요 고객사 업체등록 등으로 반도체 검사부품 중심의 성장 기반 구축

핵심 기술 및 적용제품


MEMS 기반 M-POGO Pin 기술	<ul style="list-style-type: none"> 자체 MEMS 기반 M-POGO Pin 기술은 미세 피치, 낮은 접촉압, 반복 접촉 안정성, 고주파 신호 대응이 필요한 Test Socket과 Vertical Probe Card에 적용
반도체 Test Socket 및 HBM 검사부품 기술	<ul style="list-style-type: none"> M-POGO Test Socket은 패키징 완료 반도체의 전기적 특성과 기능을 검증하는 후공정 검사부품으로, HBM 및 AI 반도체 등 고성능 제품 대응 추진
Probe Card 및 Test Interface Board 기술	<ul style="list-style-type: none"> 웨이퍼 단계 검사용 Vertical Probe Card와 고속 신호전달용 Test Interface Board를 통해 전공정·후공정 검사 환경을 모두 겨냥

시장경쟁력

HBM·AI 반도체 수요 대응 가능성	<ul style="list-style-type: none"> HBM 및 AI 반도체 확산으로 고정밀 검사부품 수요가 확대되는 가운데, 동사의 M-POGO 기반 제품군은 해당 시장 변화와 직접적으로 연결
소모성 부품 기반 반복 매출 가능성	<ul style="list-style-type: none"> Probe Card와 Test Socket 등 검사부품은 반복 접촉에 따른 교체 수요가 발생하므로, 양산 고객 확보 시 장비 수주 대비 안정적인 반복 매출 구조 형성
고객사 인증 이후 진입장벽 형성 가능성	<ul style="list-style-type: none"> 반도체 검사부품은 고객사 수율과 장비 가동률에 영향을 미치는 핵심 부품이므로, 양산 검증 통과 이후 장기 거래 관계와 전환비용 기반의 진입장벽 형성 가능

VRIO 분석 (VRIO Analysis)

VRIO(브리오) 분석이란 기업이 보유한 경영자원과 활용 능력을 가치(Value), 희소성(Rarity), 모방 가능성(Imitability), 조직(Organization)이라는 기준으로 분석하는 도구

			
<p>가치(Value)</p>	<p>희소성(Rarity)</p>	<p>모방가능성(Imitability)</p>	<p>조직(Organization)</p>
<ul style="list-style-type: none"> 동사의 기술은 HBM·AI 반도체 확산에 따른 고정밀 검사부품 수요 증가에 대응할 수 있어 사업적 가치가 있다. 	<ul style="list-style-type: none"> 자체 MEMS Fab 기반 접촉부품 제조와 사업 인수를 통해 신호전달 부품 역량을 함께 보유한 점은 국내 중소 검사부품 기업 중 차별화된 요소로 판단된다. 	<ul style="list-style-type: none"> MEMS 공정, 접촉 구조 설계, 고객사 검증 경험, IP 포트폴리오 결합으로 단기 모방은 쉽지 않으나, 글로벌 선도업체와 대형 경쟁사의 기술 개발 가능성은 존재한다. 	<ul style="list-style-type: none"> 반도체 사업본부 신설, 전문 인력 확보, 주요 고객사 등록, TIU 사업부 인수를 통해 보유기술을 사업화하기 위한 조직 기반을 강화하고 있다.

I. 기업 현황

고객 다변화 및 반도체 검사부품 사업 영역 확장으로, 성장성과 수익 안정성을 강화 시도 중
 당사는 2017년 코넥스 시장에 상장한 정밀 검사 솔루션 기업으로, 디스플레이 검사장비·검사부품을 기반으로 반도체 검사부품까지 사업을 확장하고 있다. OLED·LCD 검사장비와 Probe Unit을 공급하며, 반도체 부문에서는 자체 MEMS 기반 M-POGO Pin, Test Socket, Probe Card, Test Interface Board 등을 개발·제조한다. 향후 성장의 핵심은 디스플레이 장비 매출 변동성을 부품 매출로 보완하고 반도체 고객사향 양산 매출을 확대하는 데 있다.

■ 기업 개요

당사는 2007년 10월 디스플레이 검사장비, 검사부품 및 반도체 부품 관련 제품의 제조·판매를 목적으로 설립된 정밀 검사 솔루션 기업으로 2017년 7월 코넥스 시장에 상장되었다. 설립 초기에는 디스플레이 검사부품을 기반으로 사업을 시작했으나, 이후 검사장비와 반도체 검사부품으로 사업 영역을 확장하면서 반도체와 디스플레이 검사 기술을 함께 보유한 기업으로 전환하고 있다.

당사의 핵심 사업모델은 디스플레이 및 반도체 제조공정에서 사용되는 검사장비와 소모성 검사부품을 개발·제조·판매하는 구조다. 디스플레이 부문에서는 OLED(Organic Light Emitting Diode) 및 LCD(Liquid Crystal Display) 패널의 Cell·Module 공정 검사장비와 Probe Unit을 공급하며, 반도체 부문에서는 M-POGO Pin, Test Socket, Probe Card, Test Interface Board 및 Connector를 공급한다. 특히 반도체 검사부품은 반복 접촉에 따른 교체 수요가 발생하는 소모성 부품 성격을 지니고 있어, 장비 매출 대비 상대적으로 반복 매출 구조를 형성할 수 있는 사업으로 판단된다. 한편, 국내 디스플레이 및 반도체 대형 제조사와 미국, 일본, 중국, 베트남, 대만, 브라질 등 해외 고객사를 주요 고객으로 확보하였다.

생산 측면에서 당사는 2011년부터 MEMS(Micro-Electro-Mechanical Systems) Fab 투자를 진행해 왔으며, 자체 MEMS Fab에서 M-POGO Pin 및 관련 부품을 생산하는 기반을 확보했다. 이를 통해 반도체 전공정 웨이퍼 검사용 Probe Card와 후공정 패키지 검사용 Test Socket을 자체 기술로 생산하고 있다. 2024년 (주)ISC로부터 TIU(Test Interface Unit) 사업부를 인수하면서 검사장비와 Test Socket 사이의 전기적 신호 전달을 담당하는 Interface Board까지 사업 범위를 확장했다.

핵심 경쟁력은 자체 MEMS 기반 M-POGO Pin 기술, 디스플레이 검사장비 양산 경험, AI(Artificial Intelligence) 기능이 탑재된 무인 자동검사 알고리즘, 그리고 반도체 검사부품 수직계열화 역량으로 요약된다.

다만 2025년 매출은 디스플레이 고객사의 투자 지연으로 전년 대비 감소했다. 당사는 향후 장비 중심 매출 변동성을 낮추기 위해 반도체 및 디스플레이 검사부품 매출 확대를 추진하고 있으며, 이를 통해 Test Total Solution 제공 기업으로의 전환을 지향하고 있다.

[표 1] 동사의 주요 연혁

일시	내용
2007.10	루켄테크놀러지스 법인 설립
2008.01	기업부설 연구소 설립
2008.08	품질경영시스템 ISO 9001 인증
2016.05	반도체 Contact Probe M-POGO Pin 개발
2017.07	코넥스 시장 상장
2024.04	(주)ISC의 TIU 사업부 영업 양수
2024.08	삼성전자 업체 등록
2025.03	SK하이닉스 업체 등록

자료: 동사 사업보고서(2026.03), 서울평가정보(주) 재구성

■ 주주 현황

2025년 말 기준 동사의 최대주주는 안윤태로, 전체 발행주식(11,156,602주) 중 4,368,000주의 주식을 보유하고 있으며, 이는 전체 지분의 39.15%에 해당한다. 다음으로 이현애 외 8인의 특수관계자가 697,434주(6.25%)의 주식을 보유하고 있어, 최대주주 및 특수관계자가 보유한 주식의 지분을 합계는 약 45.40%로 확인된다. 나머지 6,091,168주(54.60%)는 소액주주 등 일반 주주가 보유하고 있다.

동사의 지배구조는 대표이사 및 특수관계인 중심의 오너 경영 체제에 가깝고, 장기 연구개발 투자와 사업 전환 전략을 일관되게 추진하는 데 유리할 수 있으나, 코넥스 상장사 특성상 유동성, 정보 접근성, 외부 감시 기능은 코스닥·유가증권시장 상장사 대비 제한적일 수 있다. 향후 반도체 검사부품 사업 확대 과정에서 경영 의사결정의 투명성, 자금조달 구조, 주요 고객사 의존도 관리가 지배구조 측면의 주요 관찰 요인으로 판단된다.

[표 2] 동사의 주요 주주 현황(보통주 기준)

주주명	소유주식수(주)	지분율(%)	관계
안윤태	4,368,000	39.15%	최대주주
이현애 외 8인	697,434	6.25%	특수관계인
기타 주주	6,091,168	54.60%	
합계	11,156,602	100.00%	

자료: 동사 사업보고서(2026.03), 서울평가정보(주) 재구성

■ 사업 영역

동사의 사업 영역은 디스플레이 검사장비, 디스플레이 검사부품, 디스플레이 기타, 반도체 검사부품으로 구분된다. 매출 구조상 디스플레이 관련 사업이 여전히 주력 기반을 형성하고 있으나, 반도체 검사부품 매출 비중이 확대되면서 사업 포트폴리오가 점진적으로 다변화되고 있다.

디스플레이 검사장비 사업은 동사의 핵심 매출 기반으로 AMI(Automatic Module Inspection), Auto Prober, Laser Repair, LT Touch 검사기 등 OLED 및 LCD 패널의 Cell·Module 공정에서 사용되는 검사장비를 공급하고 있다. 해당 장비는 패널 제조 과정에서 발생하는 결함을 검사하고 수율 개선에 기여하나, 고객사의 설비투자 일정과 신규 라인 증설 여부에 따라 수주 규모가 달라지고 매출 변동성이 상대적으로 크다.

디스플레이 검사부품 사업은 Probe Unit, Probe Block 등 패널 점등검사용 접촉 부품을 공급하는 사업이다. 해당 부품은 검사장비와 디스플레이 패널의 패드부를 전기적으로 연결하는 역할을 하며, 생산라인 가동 과정에서 교체 수요가 반복적으로 발생한다. 검사장비 대비 개별 프로젝트 규모는 작을 수 있으나, 장비 설치 이후에도 유지·보수 및 교체 수요가 발생한다는 점에서 매출 안정성 확보에 기여하는 사업으로 판단된다.

디스플레이 기타 사업은 검사장비 관련 용역, Parts 및 기타 부대 매출로 구성된다. 해당 사업은 장비 설치, 유지보수, 고객사 생산라인 대응, 부품 교체 등 장비 공급 이후 발생하는 후속 서비스 성격이 강하고, 매출 비중은 제한적이나 고객사와 관계를 유지하고 장비 운용 안정성을 지원하는 역할을 한다. 즉, 해당 사업은 독립적인 성장축이라기보다 디스플레이 검사장비 및 검사부품 사업을 보완하는 지원 사업으로 볼 수 있다.

루켄테크놀로지스(162120)

반도체 검사부품 사업은 동사의 성장 사업으로 M-POGO Pin을 기반으로 Test Socket, Vertical Probe Card, Test Interface Board, Connector 등을 공급하며, 반도체 전공정 웨이퍼 검사와 후공정 패키지 검사로 대상으로 제품군을 확대하고 있다. 2024년 TIU 사업부 인수 이후 Interface Board까지 제품 범위가 확대되면서, 검사장비와 반도체 칩 사이의 접촉·신호전달 부품을 포괄하는 구조가 형성되었다. 2025년 반도체 검사부품 매출 비중이 확대된 점은 동사의 사업 전환 방향을 보여주는 지표로 판단된다.

[표 3] 동사의 주요 제품 매출실적

(단위 : 억 원, %)

구분	2023년	비중	2024년	비중	2025년	비중	
디스플레이	검사장비	315.1	81.8%	111.4	53.1%	75.2	43.4%
	검사부품	53.4	13.9%	64.7	30.8%	39.3	22.7%
	기타	16.1	4.2%	19.6	9.4%	18.8	10.9%
반도체	검사부품	0.4	0.1%	14.1	6.7%	39.8	23.0%
	매출 합계	385.0	100.0%	209.8	100.0%	173.1	100.0%

자료: 동사 사업보고서(2026.03), 서울평가정보(주) 재구성

■ 판매조직 및 판매전략

동사는 표준 제품을 대량 유통하는 일반 영업보다는 고객사의 공정 사양에 맞춰 제품을 설계·검증·등록한 후 공급하는 기술 기반 프로젝트형 영업에 가깝다. 고객사가 요구하는 제품 사양을 영업부서와 설계부서가 검증한 뒤 제품 등록, 생산 일정 협의, P/O(Purchase Order) 접수, 제품 생산 및 최종 공급의 절차를 거친다. 이는 검사장비와 검사부품 모두 고객 공정에 대한 이해와 기술 검증이 수주 경쟁력의 핵심임을 의미한다.

디스플레이 고객사와의 장기 거래 관계를 기반으로 반도체 고객사로 확장하는 방식으로 고객을 확보하고 있다. 디스플레이 부문에서는 LG디스플레이 공급 레퍼런스를 통해 삼성디스플레이로 공급 범위를 확대하고 있다. 반도체 부문에서는 삼성전자 검사부품 공급사 등록 이후, SK하이닉스 및 중국 CXMT에 공급사로 등록하고 중국, 대만 등 확장을 위한 에이전시 계약을 체결하여 고객 포트폴리오가 확대되는 국면이다. 다만 실제 매출 확대는 고객사 평가, 양산 승인, 후속 물량 확보가 전제되어야 하므로 단기 실적 기여도는 보수적으로 볼 필요가 있다.

검사장비는 수주 후 설계, 제작, 검수, 출하까지 약 4개월의 시간이 소요되며 장기 공급계약 비중은 적은 편이다. 반면 검사부품은 고객사의 생산라인 가동과 유지보수 과정에서 수시 수요가 발생하고 단납기 공급이 요구된다. 따라서 동사가 장기적으로 검사부품 비중을 높이는 전략은 매출 변동성 완화와 고객 락인(lock-in) 효과를 동시에 겨냥한 것으로 판단된다.

경쟁 전략은 자체 MEMS 기술, 납기 대응력, 고객 맞춤형 설계 역량, 해외 영업 거점 확보에 기반하고, 해외 고객 확대를 위해 현지 연락사무소 및 베트남 법인을 설립하여 고객 대응 속도를 높이고 있다. 다만 반도체 검사부품 시장은 기존 글로벌 및 국내 전문업체와 경쟁이 존재하고, 고객사 인증 절차가 길며, 불량 발생 시 신뢰성 리스크가 클 수 있다. 따라서 동사의 판매전략은 신규 고객 확보뿐 아니라 검증된 모델의 양산 전환률을 높이는 방향으로 전개될 필요가 있다.

II. 시장 동향

HBM 및 AI 반도체 확산으로 고정밀 검사부품 수요가 확대되는 시장

목표시장은 반도체 검사장비와 디바이스를 연결해 전기적 특성, 기능, 신뢰성을 검증하는 Probe Card, Test Socket, Test Interface Board 등을 포괄한다. 칩 미세화, 패키지 고도화, HBM 및 AI 반도체 확산으로 테스트 난이도가 높아지면서 고정밀·고신뢰성 검사부품 수요가 확대되고 있다. 특히 Probe Card와 Test Socket은 반복 접촉에 따른 교체 수요가 발생해 양산라인 가동률과 제품 세대 전환에 연동되는 반복 매출 구조를 형성할 수 있다. 당사는 M-POGO Pin 기반 접촉부품과 Interface Board 제품군으로 시장 변화에 대응하고 있다.

■ 반도체 검사부품 시장의 특성

당사의 목표시장은 반도체 검사부품 시장으로, 반도체 제조공정에서 칩의 전기적 특성, 기능, 신뢰성을 검증하기 위해 사용되는 접촉부품 및 신호전달 부품 시장을 의미한다. 이는 검사장비와 반도체 디바이스 사이에서 전기적 연결을 수행하는 Probe Card, Test Socket, Test Interface Board, Connector, Contact Pin 등을 포괄하는 시장이다.

반도체 검사부품은 크게 전공정용 부품과 후공정용 부품으로 구분된다. 전공정에서는 웨이퍼 상태의 칩을 검사하기 위해 Probe Card가 사용되고, 후공정에서는 패키징이 완료된 반도체의 전기적 특성과 성능을 확인하기 위해 Test Socket이 사용된다. Test Interface Board와 Connector는 검사장비와 검사 대상 디바이스 사이에서 신호를 전달하고 테스트 조건을 안정적으로 구현한다. 따라서 시장의 수요는 반도체 제조사의 설비투자뿐 아니라 웨이퍼 투입량, 패키지 출하량, 제품 세대 전환, 검사 항목 증가와 연동된다.

Probe Card와 Test Socket 등은 검사 과정에서 반도체 칩 또는 패키지와 반복적으로 접촉하기 때문에 마모와 성능 저하가 발생하며, 생산라인 가동이 지속되는 한 교체 수요가 발생한다는 점에서 소모성 부품 시장에 해당한다. 이 때문에 검사부품 시장은 장비 투자 사이클에만 의존하는 시장이라기보다, 반도체 양산 물량과 가동률에 따라 반복 수요가 형성되는 구조를 가진다. 당사가 장비 중심 매출 변동성을 낮추기 위해 반도체 검사부품 매출 확대를 추진하는 배경도 이러한 시장 특성과 관련된다.

기술 측면에서 목표시장은 미세화와 고성능화에 따라 진입장벽이 높아지고 있다. 반도체 칩의 전극 간격이 좁아지고 패키지 구조가 복잡해질수록 접촉부품은 더 작은 피치에서 안정적인 접촉을 구현해야 하며, 고속 신호 환경에서는 신호 손실, 노이즈, 임피던스 제어, 병렬 테스트 대응 능력이 중요해진다. 특히 고성능 메모리, AI 가속기, 고성능 로직 반도체에서는 테스트 속도와 정확성이 수율 및 출하 품질에 직접적인 영향을 미치기 때문에 검사부품의 신뢰성 요구 수준이 높다.

경쟁 구조는 고객사 인증과 양산 검증 중심으로 형성된다. 반도체 검사부품은 고객사의 생산 수율, 검사 정확도, 장비 가동률에 영향을 주기 때문에 신규 공급업체가 단기간에 진입하기 어렵다. 제품 개발 이후에도 고객사 평가, 신뢰성 검증, 양산라인 적용 여부를 거쳐야 하며, 적용 이후에는 품질 안정성, 납기 대응력, 제품 수명, 원가 경쟁력이 지속적으로 평가된다. 따라서 해당 시장은 기술 진입장벽과 고객사 전환비용이 동시에 존재하는 시장으로 판단된다.

■ 핵심 트렌드 및 시사점

반도체 검사부품 시장의 가장 중요한 성장 요인은 반도체 고성능화에 따른 테스트 난이도 상승이다. AI 서버, 데이터센터, 고성능 컴퓨팅용 반도체 수요가 확대되면서 고대역폭, 고집적, 저전력 특성을 갖춘 반도체의 비중이 증가하고 있다. 이에 따라 단순 기능 검사뿐 아니라 고속 신호, 열 조건, 전력 특성, 장시간 신뢰성 등을 검증하는 테스트의 중요성이 커지고 있다. 이러한 변화는 Probe Card, Test Socket, Test Interface Board 등 검사부품의 수요 기반을 확대하는 요인으로 작용한다.

HBM 확산은 검사부품 시장의 기술 고도화를 촉진하는 대표적 요인이다. HBM은 여러 개의 DRAM(Dynamic Random Access Memory) 다이를 적층해 높은 대역폭을 구현하는 메모리로, 적층 단수 증가와 분당 공정 고도화에 따라 웨이퍼 단계 및 패키지 단계의 검사 중요성이 커지고 있다. TrendForce는 HBM의 전체 DRAM 비트 용량 비중이 2024년 5%에서 2025년 10% 이상으로 상승하고, 시장가치 기준으로는 2025년 전체 DRAM 시장의 30%를 초과할 가능성이 있다고 전망했다. 이는 HBM 관련 테스트 공정과 검사부품 수요 증가를 뒷받침하는 시장 환경으로 해석된다.

한편, 글로벌 Probe Card 시장은 2026년 27.1억 달러에서 2031년 42.3억 달러로 연평균 9.3% 성장이 전망된다. 특히 칩렛, 3D 적층, 이중 집적 등 첨단 패키징 구조가 확대될수록 웨이퍼 단계에서 선별 검사 필요성이 높아지고, 이는 고성능 Probe Card 수요 증가로 연결될 가능성이 있다. 또한 글로벌 반도체 Test Socket 시장은 2024년 12.2억 달러에서 연평균 7.0% 성장할 것으로 전망된다. 고성능 반도체 출하량 증가와 패키지 구조 다변화는 Test Socket의 신규 수요와 교체 수요를 동시에 확대할 수 있다.

정책 및 공급망 측면에서는 주요국의 반도체 생산능력 내재화 정책이 중장기적으로 검사부품 수요 기반을 확대할 가능성이 있다. 미국 CHIPS and Science Act, 유럽 반도체법, 일본 및 기타 지역의 반도체 투자 인센티브는 웨이퍼 생산과 패키징 투자 확대를 유도하고 있으며, 이는 테스트 공정과 검사부품 수요 증가로 이어질 수 있다. 다만 검사부품 수요는 단순한 투자 발표보다 실제 양산라인 가동, 고객사 인증, 제품 세대 전환 속도에 더 직접적으로 영향을 받기 때문에 실적 반영 시점에는 차이가 발생할 수 있다.

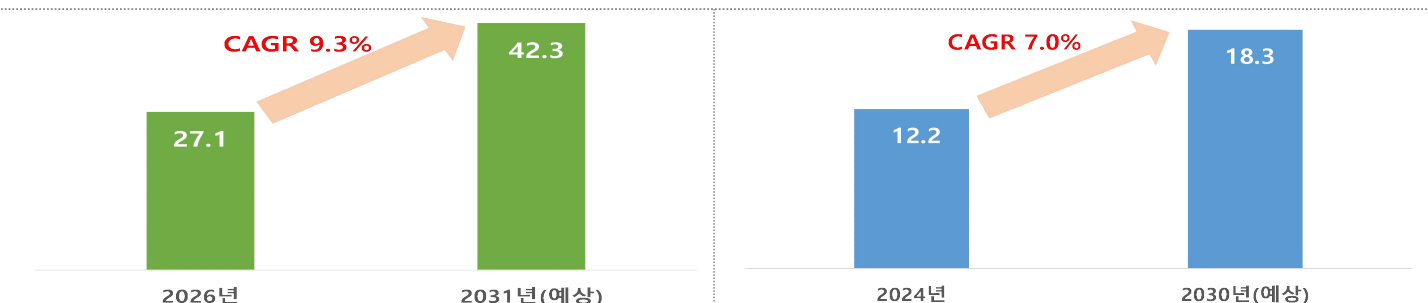
시장의 변화는 동사에 기회와 리스크를 동시에 제공한다. 기회 요인은 HBM 및 고성능 반도체 확산, Probe Card와 Test Socket 시장 성장, Test Interface Board의 신호전달 중요성 확대, 검사부품의 반복 교체 수요다. 동사가 보유한 M-POGO Pin 기반 접촉부품과 Interface Board 및 Connector 제품군은 이러한 시장 방향과 부합한다. 반면 고객사 인증 지연, 양산 품질 검증 부담, 기존 글로벌 공급업체와의 경쟁, 반도체 업황 변동은 주요 리스크다. 따라서 동사의 시장 기회는 반도체 검사부품 시장의 성장성 자체보다, 보유 제품이 주요 고객사의 양산 공정에 안정적으로 채택되고 반복 매출로 전환되는지 여부에 의해 구체화될 것으로 판단된다.

[그림 1] 글로벌 Probe Card 시장

(단위 : 억 달러)

[그림 2] 글로벌 반도체 Test Socket 시장

(단위 : 억 달러)



자료: Mordor Intelligence, QY Research, 서울평가정보(주) 재구성

III. 기술분석

자체 MEMS 기반 M-POGO Pin 기술과 고속 신호전달 설계 역량 보유

동사의 핵심 기술은 자체 MEMS Fab 기반의 M-POGO Pin 제조기술과 고속 신호전달 설계기술로, M-POGO Pin을 Test Socket, Vertical Probe Card, HBM 검사부품 등에 적용하며, 미세 피치 대응, 낮은 접촉압, 고주파 신호 대응, 반복 접촉 안정성을 차별화 요소로 확보하고 있다. 연구개발은 디스플레이 검사장비에서 고성능 반도체 검사부품으로 이동하고 있으며, 다수의 지식재산권을 통해 접촉부품·소켓·인터페이스 보드 관련 기술을 보호하고 있다.

■ 핵심 보유기술 및 특징점

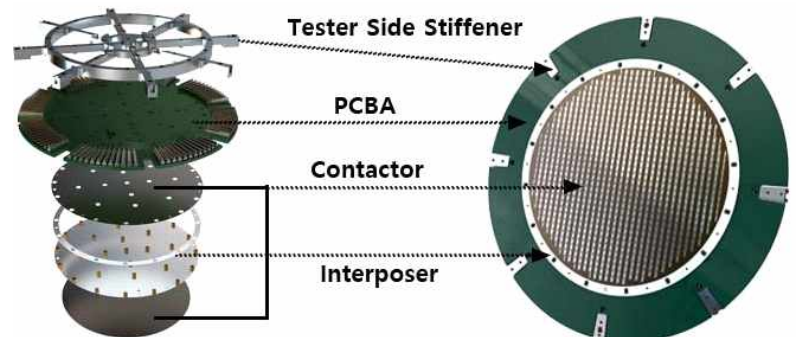
동사의 핵심 보유기술은 MEMS 기반 정밀 접촉부품 제조기술과 고속 신호전달 설계기술로 요약된다. 자체 MEMS Fab에서 반도체 검사 접점부품인 M-POGO Pin을 생산하고 있으며, 이를 M-POGO Test Socket, M-POGO Vertical Probe Card, HBM 검사부품 등에 적용하고 있다. 특히 M-POGO Pin은 Plunger, Spring, Barrel이 일체화된 수직형 접촉 핀 구조로, 미세 피치와 고주파 특성이 요구되는 반도체 검사 환경에 대응하는 핵심 부품이다. 동사는 MEMS Fab에서 65 μ m 수준의 Fine Pitch 구현이 가능하고, 웨이퍼 1장당 10만~40만 개 수준의 핀 양산 생산성을 확보했다.

M-POGO 기반 기술은 기존 POGO Pin 방식과 Rubber Socket 방식의 한계를 보완하는 방향으로 개발되었다. Fine Pitch가 0.25mm 이하로 축소되는 경우 일반 POGO Pin 방식은 정렬 및 접촉 안정성 확보가 쉽지 않으나, 동사는 MEMS 공정을 통해 1~5gf 수준의 낮은 스프링 압력을 갖는 제품을 개발하여 BGA(Ball Grid Array) 손상 가능성을 낮추면서 전기적 특성을 개선하고자 한다. 이는 HBM, AI 반도체, 고성능 메모리 등 미세 전극과 고속 신호 특성이 요구되는 검사부품 시장에서 차별화 요소로 작용할 수 있다.

반도체 Test Socket 기술은 후공정 검사부품 사업을 구성하는 핵심 축으로, 기존 POGO Pin 대비 Fine Pitch 대응력을 확보하면서도 우수한 전기적·기계적 특성을 지향한다. 또한 동사는 M-POGO Pin뿐 아니라 Socket Housing을 MEMS 기반으로 제작해 위치 정밀도와 생산 효율성을 확보하고 있으며, 웨이퍼 기반 Socket Housing은 -40 $^{\circ}$ C~120 $^{\circ}$ C의 테스트 환경에서도 물성 변화가 제한적이다.

Probe Card 기술은 전공정 검사부품 사업과 HBM 검사부품 확장 가능성을 보여주는 영역이다. 동사는 M-POGO Contact Pin Block, M-POGO Interposer Pin Block을 자체 생산하고, 고가·장납기 부품인 MLC(Multi Layer Ceramic)를 MEMS 공정 기반 Interposer로 대체하는 구조의 M-POGO Vertical Probe Card를 개발했다. 이 구조는 웨이퍼 단계에서 미세 전극에 수직 접촉하는 방식으로, HBM Burn-In Test와 같은 고정밀 검사 수요에 대응하기 위한 기술적 기반으로 판단된다. 특히 자체 웨이퍼 인터포저 기술과 PCB(Printed Circuit Board)를 결합한 하이브리드 인터포저는 원가와 납기 측면에서 경쟁력을 확보하려는 접근으로 해석된다.

[그림 3] 동사의 M-POGO Vertical Probe Card



자료: 동사 홈페이지, 서울평가정보(주) 재구성

■ 연구개발 역량

동사의 연구개발활동은 디스플레이 검사장비 기술에서 출발해 반도체 검사부품 기술로 확장되어 왔다. 초기 연구개발은 수직형 Probe Unit Block, 자동 Cell 검사장치, 전자 디바이스 검사장치, 필름형 Probe Unit 등 디스플레이 검사공정에 필요한 장비·부품 중심으로 진행되었다.

반도체 분야 연구개발은 2011년 MEMS 장비 및 인원 투자 이후 본격화되었고, 2016년부터 M-POGO Pin 개발이 주요 과제로 추진되었다. 2022년 Test Socket 개발을 통해 고집적·고속화되는 반도체 디바이스 트렌드에 대응하는 M-POGO Pin 기반 소켓 특성을 확보했고, 2022년 Probe Card용 Fine Pitch 대응 기술 개발도 진행했다. 2025년에는 프로브 핀, 반도체 테스트시스템의 전류증폭장치, 소켓 분리용 툴 장치 관련 과제를 추진했고, 2026년에는 65 μ m 피치 구현이 가능한 초미세 수직형 접촉 프로브 개발이 진행 중이다.

최근 HBM 및 고성능 반도체 검사부품 중심으로 연구개발 진행 중으로, 동사는 HBM Die Level 검사용 HBM Vehicle, HBM용 Test Socket, HBM Burn-In 및 기능 테스트용 Vertical Probe Card를 개발하고 있으며, HBM3E 및 HBM4 대응 가능성을 언급하고 있다. HBM 제조공정이 8~16단 적층으로 고도화되면서 Wafer Burn-In 공정의 필요성이 커지고 있어, 동사의 Vertical Probe Card와 HBM Vehicle 개발은 고성능 메모리 검사공정 변화에 대응하는 연구개발 방향으로 판단된다. 한편, 동사는 HBM 관련 제품 설계에 필요한 PCB 설계 규칙과 기술 확보를 목적으로 TIU 사업부를 인수하였고, 이후 연구개발 범위는 접촉부품에서 회로·보드 설계 영역으로 확대되었다. 이는 M-POGO Pin, Socket Housing, Interposer, Interface Board를 개별 부품이 아니라 하나의 검사 신호 경로로 설계·최적화하려는 연구개발 방향으로 해석된다.

■ 지식재산권 현황

동사는 반도체 및 디스플레이 검사기술과 관련해 특허, 디자인, 상표를 포괄하는 지식재산권 포트폴리오를 보유하고 있다. 특허는 대부분 국내에 등록되어 있으나, Probe Pin 관련 미국 등록 특허와 프로브 검사 장치 관련 중국 등록 특허가 확인되어 반도체 검사 접촉부품 기술의 해외 권리화도 일부 진행된 것으로 판단된다.

특허 포트폴리오는 네 가지 축으로 구분된다. 첫째, Probe Pin, Probe Unit, Probe Film, Probe Card 등 정밀 접촉부품 관련 기술이다. 둘째, 반도체 패키지 검사용 Socket, Socket Board Assembly, Socket 분리용 툴 장치 등 후공정 테스트 부품 관련 기술이다. 셋째, Test Interface Unit, Interface Module, DSA Board, Hi-Fix Board, Connector, Test Head 등 신호전달 및 인터페이스 부품 관련 기술이다. 넷째, 디스플레이 패널 검사장치, Auto Prober, 광학 검사장치, Aging System 등 기존 디스플레이 검사장비 관련 기술이다. 이는 동사가 디스플레이 검사장비 기업에서 반도체 검사부품 기업으로 기술 포트폴리오를 확장해 온 흐름과 부합한다.

디자인권은 대부분 프로브핀 형상에 집중되어 있다. 등록 디자인 35건 중 34건이 프로브핀 관련 권리로 확인되며, 이는 동사가 M-POGO Pin을 포함한 접촉부품의 형상과 구조적 차별성을 보호하는 데 중점을 두고 있음을 의미한다. 반도체 검사부품 시장에서는 핀의 미세 구조, 접촉부 형상, 스프링 구조, 배열 안정성이 제품 성능과 직결되므로, 프로브핀 디자인권은 특허와 함께 접촉부품 경쟁력 방어 수단으로 기능할 수 있다.

상표권은 기업 브랜드와 제품 브랜드를 함께 보호하는 구조다. 등록 상표는 LUKEN, 루켄, LUKEN Technologies, M-POGO, M-POGO Semiconductor Test Solutions, M-NEEDLE 등으로 구성되어 있으며, 모두 상품분류 09류에 해당한다. 특히 M-POGO 관련 상표는 반도체 검사부품 브랜드로 활용될 수 있으며, 한국 외 미국, 일본, 중국, 대만 등 주요국에도 등록했다.

■ PEST 분석

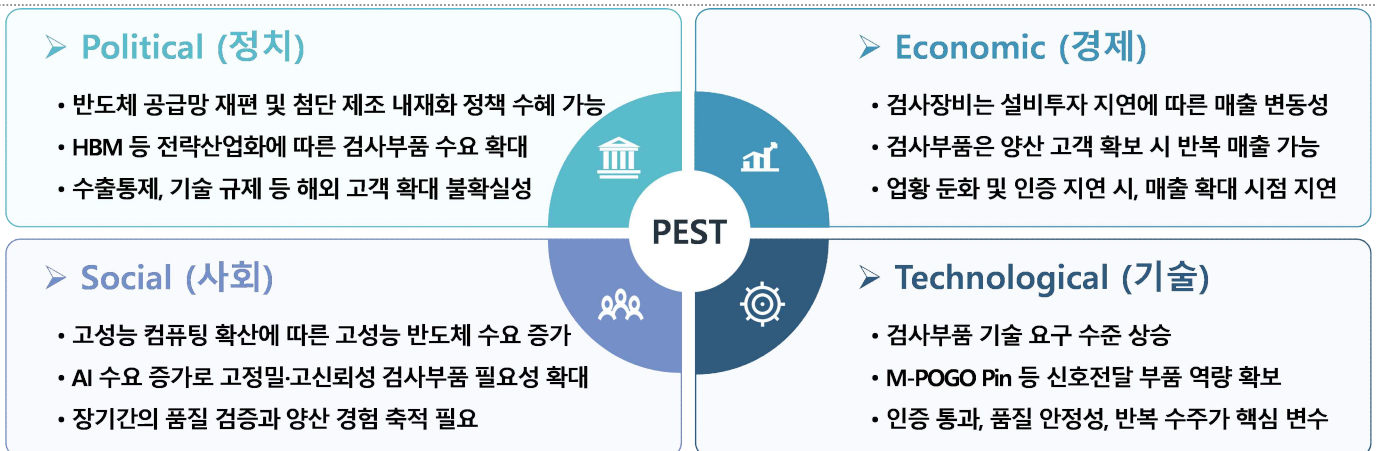
반도체 검사부품 시장은 주요국의 반도체 공급망 재편과 첨단 제조 역량 내재화 정책의 영향을 받는다. 미국, 일본, 한국 등은 반도체 생산기반 확대와 핵심 부품·소재·장비의 안정적 조달을 정책적으로 지원하고 있고, 중장기적으로 웨이퍼 검사와 패키지 테스트 공정에 사용되는 검사부품 수요 확대에 긍정적으로 작용할 수 있다. 특히 HBM, AI 반도체, 첨단 패키징 분야는 국가 전략산업으로 투자가 확대될 수 있으나, 반도체 공급망은 국가 간 기술 규제, 수출통제, 보안 요구, 지정학적 리스크에 민감하므로 정책 변화와 수출 규제 환경을 지속적으로 관리할 필요가 있다.

동사의 실적은 반도체 및 디스플레이 고객사의 설비투자과 양산라인 가동률에 영향을 받는다. 디스플레이 검사장비 사업은 고객사 투자 지연 시 매출 변동성이 크게 나타날 수 있으나, 반도체 검사부품은 Probe Card, Test Socket 등 교체 수요가 발생하는 소모성 부품 성격을 지니고 있어, 양산 고객을 확보할 경우 장비 매출 대비 안정적인 반복 매출 구조를 형성할 가능성이 있다. 그러나 고객사 인증과 양산 전환까지 시간이 소요되고, 반도체 업황이 둔화되거나 고객사 투자가 축소될 경우 매출 확대가 지연될 수 있다는 점은 리스크에 해당한다.

AI 서버, 데이터센터, 고성능 컴퓨팅, 자율주행, 고사양 모바일 기기 확산은 고성능 반도체와 고해상도 디스플레이 수요의 증가 요인으로 반도체의 고집적화와 패키지 구조 복잡화를 촉진하며, 검사 난이도 상승과 고정밀 검사부품 필요성 증가로 이어지고 있다. 특히 HBM과 AI 반도체는 고속 신호 처리와 높은 신뢰성이 요구되므로, 검사 과정에서 접촉 안정성, 신호 무결성, 미세 피치 대응이 중요해지고 있다. 동사는 자체 MEMS 기반 M-POGO Pin 기술 등을 통해 산업 수요 변화에 대응하고 있으나, 검사부품은 고객사의 생산 수율과 직결되므로, 신규 공급사에 대한 신뢰 확보에는 장기간의 품질 검증과 양산 경험 축적이 필요하다.

반도체 검사부품 시장의 기술 트렌드는 미세 피치 대응, 낮은 접촉저항, 고주파 신호 대응, 반복 접촉 수명, 고온·저온 환경 신뢰성, 신호전달 안정성으로 요약된다. 동사는 자체 MEMS Fab 기반의 M-POGO Pin 제조기술을 보유하고 있고, TIU 사업부 인수를 통해 Test Interface Board와 Connector 등 신호전달 부품까지 사업 범위를 확장하면서 접촉부품과 인터페이스 부품을 함께 제공할 수 있는 기술 구조를 갖추고 있다. 등록 특허, 디자인, 상표 등 지식재산권 포트폴리오도 접촉부품·소켓·인터페이스 보드 관련 기술을 중심으로 형성되어 있다. 다만 기술 경쟁이 빠르게 고도화되는 시장인 만큼, 동사의 기술 경쟁력은 보유 기술 자체보다 고객사 평가 통과, 양산 품질 안정성, 반복 수주 확보 여부를 통해 검증될 것으로 판단된다.

[그림 4] PEST 분석



자료: 서울평가정보(주)

IV. 재무분석

반도체 부품 성장으로 수익성 회복 기반 다지는 중

동사의 매출액은 2023년 385.0억 원, 2024년 209.8억 원, 2025년 173.1억 원으로 나타났으며, 디스플레이 검사장비 매출 감소로 외형이 축소되었으나, 반도체 부문 매출이 크게 증가하면서 매출 구조가 전환되었다. 2025년에는 매출 감소에도 매출원가율이 개선되고 영업손실이 축소되어 비용 구조 측면에서는 일부 개선 흐름이 나타났다. 그러나 판관비율과 금융비용 부담이 여전히 높아 당기순손실이 지속되었다. 재무안정성 측면에서는 총자산이 증가했으나 부채비율 상승과 유동부채 부담으로 단기 유동성 관리가 필요한 상태이다.

■ 반도체 부문 매출 크게 성장

동사의 최근 3개년 매출액은 2023년 385.0억 원, 2024년 209.8억 원, 2025년 173.1억 원으로 나타났다. 2025년에는 매출액이 전년 대비 17.5% 감소하며 외형 축소가 이어졌다.

주요 제품별로 보면 [디스플레이 검사장비] 매출은 2023년 315.1억 원, 2024년 111.4억 원, 2025년 75.2억 원으로 감소하며 전체 매출 둔화의 주된 요인으로 작용하였다. 반면 [반도체 검사부품] 매출은 2023년 0.4억 원, 2024년 14.1억 원, 2025년 39.8억 원으로 2024년 이후 크게 확대되었고, [디스플레이 검사부품]은 2023년 53.4억 원, 2024년 64.7억 원, 2025년 39.3억 원으로 변동성을 보였다. [디스플레이 기타] 매출액은 2023년 16.1억 원, 2024년 19.6억 원, 2025년 18.8억 원으로 나타났다. 수출액은 2023년 336.4억 원, 2024년 153.6억 원, 2025년 72.3억 원으로 감소하였으나, 내수 매출은 2023년 48.6억 원, 2024년 56.2억 원, 2025년 100.8억 원으로 증가하여 수출 중심 장비 매출에서 국내 반도체·부품 매출 비중이 확대되었다.

동사의 매출액은 외형 축소를 보였으나, 매출 비중의 측면에서 기존 디스플레이 부문의 중심축이 유지되는 가운데, 반도체 부문의 매출 비중이 점진적으로 확대되고 있다. 향후 삼성디스플레이가 고객사로 추가되어 매출 성장이 기대되는 한편, 반도체 사업부의 DSA Board 및 M-POGO 제품 매출 증가가 기대되는 등 반도체 중심으로 매출이 회복할 것으로 예상된다.

■ 2025년 원가율 개선으로 영업손실 축소

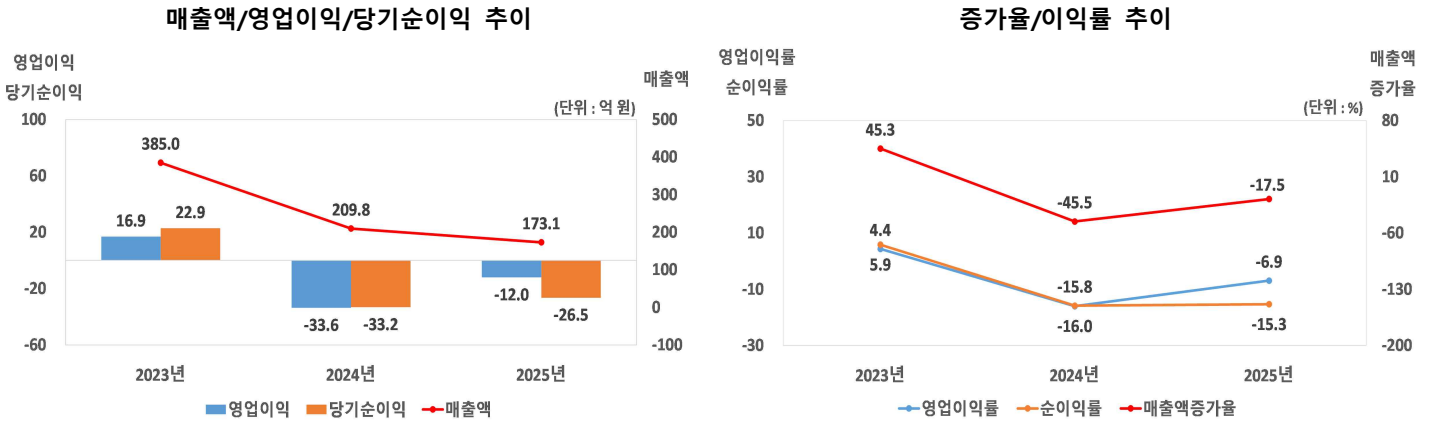
동사의 영업이익은 2023년 16.9억 원에서 2024년 -33.6억 원, 2025년 -12.0억 원으로 나타났다. 매출원가율은 2023년 77.8%, 2024년 75.6%, 2025년 64.9%로 개선되었으나, 판관비율은 2023년 17.9%, 2024년 40.4%, 2025년 42.0%로 상승하였다. 매출 축소에 따라 판관비 부담이 상대적으로 확대되었으나, 2025년에는 원가율이 개선되며 영업손실이 일부 축소된 모습을 나타냈다.

당기순이익은 2023년 22.9억 원, 2024년 -33.2억 원, 2025년 -26.5억 원으로 나타났고, 순이익률은 2023년 5.9%, 2024년 -15.8%, 2025년 -15.3%를 기록하였다. 2025년에는 영업손실이 축소되었음에도 금융비용 18.1억 원이 반영되며 순손실 지속되었으며, 이 중 이자비용은 2023년 13.2억 원에서 2024년 14.2억 원으로 상승하는 등, 차입금 및 전환사채 관련 비용 부담이 커졌다.

동사의 수익성은 2025년에 원가율 개선과 영업손실 축소가 나타났으나, 매출 규모가 판관비와 금융비용을 상쇄하기에는 부족한 상태로 판단된다. 다만, 중장기적으로 검사장비 부문 회복과 반도체 부품 매출 증가가 예상되어 매출 확대에 따른 수익 개선 가능성이 존재하는 것으로 파악된다.

[그림 5] 동사 연간 요약 포괄손익계산서 분석

(단위 : 억 원, % K-IFRS 연결 기준)



자료: 동사 사업보고서(2026.03), 서울평가정보(주) 재구성

■ 차입금 일부 감소와 자금조달 병행

동사의 총자산은 2023년 472.4억 원, 2024년 460.1억 원, 2025년 511.6억 원으로 나타났다. 유동자산은 2023년 140.9억 원에서 2024년 115.6억 원으로 감소 후, 2025년 150.3억 원으로 증가하였으며 이 중 현금및현금성자산은 2023년 2.0억 원, 2024년 16.0억 원, 2025년 52.1억 원으로 증가하였다. 차입 및 전환사채 발행으로 유동성을 일부 확보한 것으로 판단되며, 유형자산은 2024년 284.7억 원, 2025년 281.4억 원으로 규모로 생산 기반은 유지되고 있다.

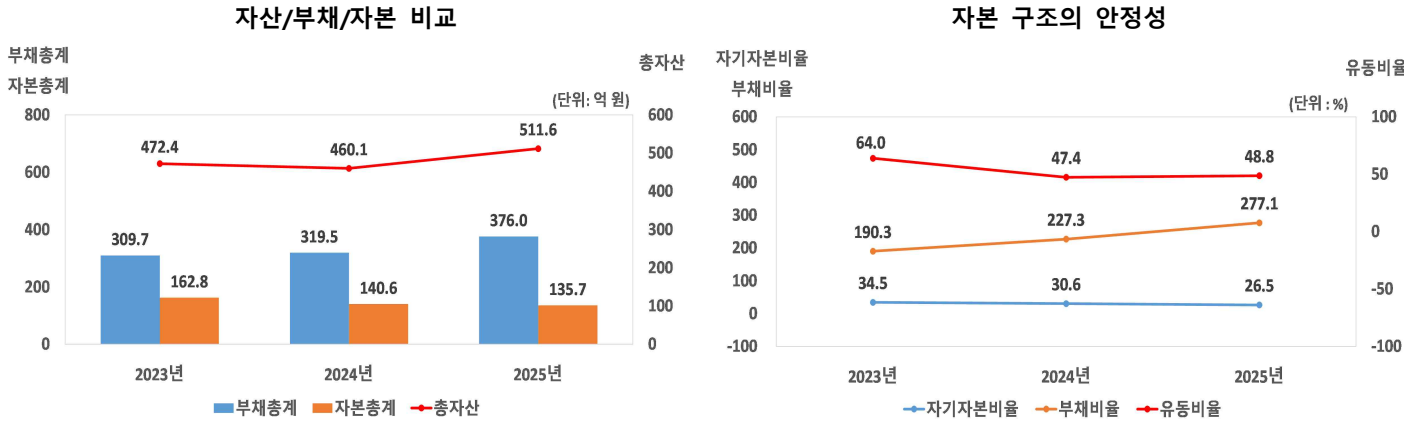
부채총계는 2023년 309.7억 원, 2024년 319.5억 원, 2025년 376.0억 원으로 증가하였다. 부채비율은 2023년 190.3%, 2024년 227.3%, 2025년 277.1%로 상승하였다. 2025년에는 차입금이 252.2억 원으로 전년 대비(258.2억 원) 감소하였으나, 2025년 10월 발행가액 70.0억 원 규모의 무이권부 무보증 사모 전환사채를 발행하는 등 외부자금조달을 추가로 진행하였다.

자본총계는 2023년 162.8억 원, 2024년 140.6억 원, 2025년 135.7억 원으로 감소하였다. 자기자본비율은 2023년 34.5%, 2024년 30.6%, 2025년 26.5%로 낮아졌으며, 누적 순손실로 결손금을 나타냈다. 다만, 토지재평가차익 19.2억 원으로 일부 자본을 보전하였다.

동사의 핵심 재무지표는 다소 약화되었으나, 2026년 반도체 부문의 성장을 통한 매출 회복, 금융비용 부담 관리를 통해 점진적으로 개선될 가능성이 있다.

[그림 6] 동사 연간 요약 재무상태표 분석

(단위 : 억 원, % K-IFRS 연결 기준)



자료: 동사 사업보고서(2026.03), 서울평가정보(주) 재구성

[표 4] 동사 연간 요약 재무제표

(단위 : 억 원, % K-IFRS 연결 기준)

항목	2023년	2024년	2025년
매출액	385.0	209.8	173.1
매출액증가율(%)	45.3	-45.5	-17.5
영업이익	16.9	-33.6	-12.0
영업이익률(%)	4.4	-16.0	-6.9
순이익	22.9	-33.2	-26.5
순이익률(%)	5.9	-15.8	-15.3
부채총계	309.7	319.5	376.0
자본총계	162.8	140.6	135.7
총자산	472.4	460.1	511.6
유동비율(%)	64.0	47.4	48.8
부채비율(%)	190.3	227.3	277.1
자기자본비율(%)	34.5	30.6	26.5
영업현금흐름	13.7	42.7	-9.9
투자현금흐름	-6.4	-33.4	-14.8
재무현금흐름	-8.4	4.7	60.8
기말현금	2.0	16.0	52.1

자료: 동사 사업보고서(2026.03), 서울평가정보(주) 재구성

■ 동사 실적 전망

디스플레이 검사장비는 당분간 주요 매출원으로 유지될 전망이다. 해당 부문 매출은 2023년 315.1억 원에서 2025년 75.2억 원으로 크게 감소했으나, 2026년에는 155.0억 원으로 회복이 예상된다. 2026년 예상 매출은 2023년 수준에는 미치지 못하나, 디스플레이 고객사 다변화에 따른 매출 증가 가능성이 있다. 다만 설비투자 사이클 회복 여부가 여전히 실적 변동의 핵심 변수로 남아 있다. 한편, 디스플레이 검사부품은 장비 매출 변동성을 보완하는 역할을 할 것으로 판단된다. 해당 부문 매출은 2025년 39.3억 원으로 전년 대비 감소했고, 2026년에는 47.2억 원으로 회복이 예상되며, 장비 공급 이후 생산라인 가동과 유지보수 과정에서 발생하는 교체 수요가 매출 기반으로 작용할 가능성이 있다. 다만 디스플레이 검사장비 및 부품은 전방 고객사의 라인 가동률과 신규 모델 대응 여부에 영향을 받기 때문에 안정적 성장 여부는 고객사 수요 회복 속도에 좌우될 것으로 보인다.

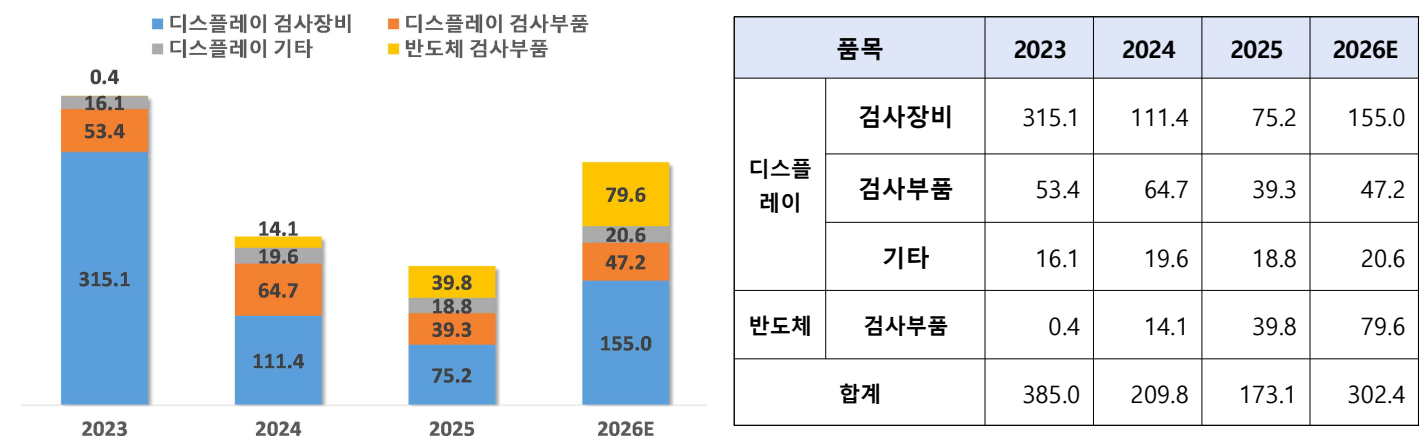
디스플레이 기타 매출은 상대적으로 안정적인 보조 매출원으로 판단된다. 해당 부문은 2023년 16.1억 원, 2024년 19.6억 원, 2025년 18.8억 원을 기록했으며, 2026년에는 20.6억 원으로 소폭 증가가 예상된다. 장비 관련 용역, Parts, 유지보수 성격의 매출로 구성되는 만큼 성장성은 제한적이나, 기존 고객사와의 관계 유지와 장비 운용 지원 측면에서 사업 포트폴리오의 안정성을 보완하는 역할을 수행할 것으로 판단된다.

국내 반도체 산업은 AI 서버와 HBM 수요 확대를 중심으로 업황 회복 기대가 높아지고 있으며, 2026년에는 메모리 업체의 투자가 범용 생산능력 확대보다 HBM 및 첨단 공정 전환에 집중될 것으로 전망된다. 관련하여 향후 실적 개선의 핵심은 반도체 검사부품 부문이다. 동사의 반도체 검사부품 매출은 2023년 0.4억 원에 불과했으나, 2024년 14.1억 원, 2025년 39.8억 원으로 증가했으며, 2026년에는 79.6억 원으로 큰 폭의 성장이 예상된다. 이는 동사가 디스플레이 검사장비 중심 기업에서 반도체 검사부품 기업으로 사업 구조를 전환하고 있음을 보여주는 핵심 지표다.

종합하면 동사의 2026년 실적은 디스플레이 부문의 제한적 회복과 반도체 검사부품의 고성장이 결합되며 반등할 것으로 전망된다. 특히 M-POGO Pin, Test Socket, Probe Card, Test Interface Board 등 반도체 검사부품 제품군의 고객사 검증과 양산 매출 전환이 실적 개선의 핵심 동력으로 판단된다. 다만 고객사 인종 지연, 양산 품질 검증 부담, 반도체 업황 변동, 디스플레이 투자 지연 가능성은 여전히 주요 리스크다. 따라서 향후 실적의 관건은 반도체 검사부품 매출이 일회성 수주가 아닌 반복적 양산 매출로 정착하는지 여부에 있다.

[그림 7] 동사 연간 실적 전망

(단위 : 억 원, % K-IFRS 연결 기준)



자료: 동사 사업보고서(2026.03), 서울평가정보(주) 재구성

V. 주요 변동사항 및 향후 전망

반도체 검사부품 수직계열화와 고객사 진입을 통해 반도체용 고정밀 검사부품의 성장 도모

동사는 기존 디스플레이 검사장비·검사부품 중심 사업에서 반도체 검사부품 중심으로 사업 구조를 전환하고 있다. TIU 사업부 인수를 통해 Test Interface Board와 Connector 등 고속 신호전달 부품까지 제품군을 확장했고, 자체 MEMS 기반 M-POGO Pin 기술을 Test Socket, Probe Card 등으로 확대하고 있다. 삼성전자, SK하이닉스 등 주요 반도체 고객사 확보를 추진하면서 HBM 및 AI 반도체 확산에 따른 고정밀 검사부품 수요 증가에 대응하고 있다. 다만 향후 성과는 개발 제품의 양산 채택과 반복 매출 전환 여부에 따라 결정될 것으로 판단된다.

■ 최근 변동사항

동사는 디스플레이 부문에서 축적한 국내 주요 고객사 대응 경험을 바탕으로 반도체 고객사 확보를 추진하고 있으며, 삼성전자 검사부품 공급사 등록 이후 SK하이닉스 및 해외 고객사로의 확대 가능성을 제시하고 있다. 이는 단순히 신규 제품을 개발하는 단계에서 벗어나, 주요 반도체 제조사의 평가·등록 절차를 통해 양산 공급 가능성을 확보하려는 단계로 진입하고 있음을 의미한다. 다만 반도체 검사부품은 고객사 인증과 신뢰성 검증이 중요한 시장이므로, 고객사 등록 이후 실제 양산 물량 확보까지는 추가적인 검증 과정이 필요하다.

조직 및 기술 측면에서 반도체 사업 전담 역량이 강화되고 있다. 동사는 반도체 사업본부를 신설하고, 반도체 테스트 및 검사장비 분야의 외부 전문 인력을 영입하며 사업 추진 체계를 보강하고 있다. 또한 자체 MEMS Fab 기반의 M-POGO Pin 기술과 TIU 사업부의 고속 회로설계 역량을 결합해 고성능 반도체 검사부품 대응력을 높이고 있다. 한편 디스플레이 사업에서는 고객사의 투자 지연과 장비 수주 변동성이 부담 요인으로 작용하고 있다. 동사는 이에 대응해 디스플레이 장비 중심의 매출 구조를 검사부품, 유지보수, 반도체 검사부품 등 반복 수요가 가능한 영역으로 보완하려는 전략을 추진하고 있다.

■ 향후 전망

단기적으로는 반도체 검사부품 사업의 양산 전환 여부에 크게 좌우될 것으로 판단된다. 동사가 보유한 M-POGO Pin 기반 접촉부품 기술은 미세 피치, 낮은 접촉압, 고주파 신호 대응이 요구되는 고성능 반도체 검사 환경과 연관성이 높다. 특히 AI 서버와 데이터센터 투자 확대에 HBM 및 고성능 메모리 수요가 증가하면서, Probe Card, Test Socket, Interface Board에 대한 기술 요구 수준이 높아지고 있다. 이러한 전망 시장 변화는 동사의 반도체 검사부품 사업에 우호적인 환경을 제공할 가능성이 있다.

디스플레이 사업은 단기적 회복 가능성은 있으나, 구조적으로 고객사 설비투자 사이클의 영향을 크게 받을 수 있어, 디스플레이 검사장비는 기반 사업으로 유지하면서, Probe Unit 등 검사부품과 용역·Parts 매출을 통해 안정성을 보완할 필요가 있다. 특히 디스플레이 부문에서 축적한 정밀 접촉, 검사 알고리즘, 고객 맞춤형 장비 설계 경험은 반도체 검사부품 사업으로 확장되는 과정에서 기술적·영업적 기반으로 활용될 수 있다.

중장기적으로는 반도체 검사부품의 제품 포트폴리오 확대가 성장의 핵심이다. 동사는 M-POGO Pin을 기반으로 Test Socket과 Vertical Probe Card를 개발하고 있으며, TIU 사업부 인수를 통해 Interface Board와 Connector까지 확보했다. 이 구조는 단일 부품 공급이 아니라 검사장비와 디바이스 사이의 접촉 및 신호전달 부품을 함께 제공하는 방향으로 발전할 수 있다. 고객사 입장에서는 고속·고정밀 테스트 환경에서 부품 간 호환성과 신호 안정성이 중요해지고 있어, 동사의 통합형 제품군은 향후 차별화 요인이 될 수 있다.

루켄테크놀러지스(162120)

다만 전망에는 리스크도 병존한다. 반도체 검사부품 시장은 기존 글로벌 업체의 고객 기반이 강하고, 신규 공급업체가 진입하기 위해서는 장기간의 평가와 양산 신뢰성 검증이 필요하다. 또한 HBM 등 고성능 반도체용 검사부품은 기술 난이도가 높아 개발 완료와 실제 양산 채택 사이에 시간차가 발생할 수 있다. 따라서 동사의 향후 성과는 반도체 시장의 성장성 자체보다 고객사 평가 통과, 양산 모델 확보, 납기 및 품질 안정성 입증 여부에 의해 구체화될 것으로 판단된다.

루켄테크놀러지스(162120)

증권사 투자의견

작성기관	투자의견	목표주가	작성일
N/A	-	-	-

시장정보(주가 및 거래량)



자료: 네이버증권(2026.05.26)

최근 3개월간 한국거래소 시장경보제도 지정여부

시장경보제도란?

한국거래소 시장감시위원회는 투기적이거나 불공정거래 개연성이 있는 종목 또는 주가가 비정상적으로 급등한 종목에 대해 투자자주의 환기 등을 통해 불공정거래를 사전에 예방하기 위한 제도를 시행하고 있습니다.

시장경보제도는 「투자주의종목 투자경고종목 투자위험종목」의 단계를 거쳐 이루어지게 됩니다.

※관련근거: 시장감시규정 제5조의2, 제5조의3 및 시장감시규정 시행세칙 제3조~제3조의7

기업명	투자주의종목	투자경고종목	투자위험종목
루켄테크놀러지스	X	X	X